

MIRDC-104-A20V

次世代觸控面板設備大廠研發策略

作者：洪鼎倫

執行單位：金屬中心

中華民國一〇四年十一月

目錄

■ 摘要	1
■ 全球觸控面板設備市場介紹	2
■ 世界大廠研發策略	3
■ 結論	10



次世代觸控面板設備大廠研發策略

金屬中心 MII 產業分析師 洪鼎倫

摘要：

觸控面板設備的市場主要在於中國大陸，從製程來看，日本的設備商主要切入前段的清洗、顯影、蝕刻等製成，後段的組裝製程設備則是以台灣及中國大陸廠商為主。

目前各設備廠商的研發策略主要是跟產品別來發展，因此主要的研發方向幾乎都是以車用面板及穿戴式設備為主要發展重點，因此觸控面板設備廠商目前必須面對車用面板及穿戴式設備因為美觀的要求所以面板形狀不規則性及 3D 曲面化，這也使得面板設備如何可以快速及精確的貼合就變成設備研發的重點，目前設備大廠如芝浦、FUK 及易發精機等都積極的投入相關設備的研發，如芝浦就研發玻璃曲面貼合，而 FUK 也發表下世代的大氣曲面貼合設備、易發精機則藉著其專精的高精密恆溫熱壓著相關技術來開發相關的設備。

綜合言之，從各廠商的研發策略來看，次世代觸控面板設備短期會主要會集中在如何解決面板形狀的不規則性及 3D 曲面上，未來將會面對可撓性、新功能 IC 與裝置如何貼合上。

《2015 次世代觸控面板設備大廠研發策略》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



經濟部技術處產業技術知識服務計畫

如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>